

2023年11月10日
三菱電機株式会社

NEWS RELEASE

三菱電機として初めて「グリーンボンド」を発行
SiC パワー半導体の生産能力増強により脱炭素社会の実現に貢献

三菱電機株式会社は、環境課題の解決に貢献する事業の資金調達のため、当社として初めて、グリーンボンド（以下、本社債）を発行する予定です。本日、本社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しました。

グリーンボンドとは、企業や地方自治体等の発行体が、国内外の適格なグリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券です。本社債の発行により調達する資金は、SiC パワー半導体の新工場棟（2026年4月稼働予定）の建設や生産設備の増強等^{※1}に充当します。

本社債の発行にあたっては「グリーンボンド・フレームワーク」を策定し、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター（以下 R&I）^{※2}より、本社債発行に係る各種基準への適合性に対する外部評価を取得しました。

当社グループは、サステナビリティを経営の根幹に位置づけ、事業を通じてSDGs達成への貢献をはじめとした社会課題の解決を推進しています。

2050年を見据えた「環境ビジョン2050^{※3}」のもと、「大気、大地、水を守り、心と技術で未来へつなぐ」を「環境宣言」として掲げ、2030年度までに工場・オフィスからの温室効果ガス排出量実質ゼロ、2050年度までにバリューチェーン全体での温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すとともに、カーボンニュートラルの実現に貢献する事業の創出・拡大に取り組んでいます。

今後も当社グループは、事業を通じた社会課題の解決を加速し、SDGs達成とサステナビリティの実現に貢献してまいります。

本社債の概要

発行額	500億円(予定)
発行年限	10年以内(予定)
発行時期	2023年12月以降(予定)
資金使途	SiC パワー半導体の新工場棟(2026年4月稼働予定)の建設、生産設備の増強等
主幹事証券会社	大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
ストラクチャリング・エージェント ^{※4}	大和証券株式会社

詳細については、決定後にお知らせします。

グリーンボンド・フレームワークの策定および外部評価の取得

当社は、本社債の発行にあたって、国際資本市場協会(ICMA)による「グリーンボンド原則2021」および環境省「グリーンボンドガイドライン(2022年版)」に定められている4つの要素(1. 調達資金の使途、2. プロジェクトの評価と選定のプロセス、3. 調達資金の管理、4. レポーティング)に関する方針を記載した「三菱電機株式会社 グリーンボンド・フレームワーク」を策定しました。本フレームワークについては、第三者評価機関であるR&Iより、上記原則およびガイドラインに適合している旨のセカンドパーティ・オピニオンを取得しています。

<三菱電機株式会社 グリーンボンド・フレームワーク>

URL : https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ir/stock/bond_rating/pdf/greenbondframework.pdf

※1 2023年3月14日広報発表 <https://www.MitsubishiElectric.co.jp/news/2023/pdf/0314-b.pdf>

※2 株式会社格付投資情報センター <https://www.r-i.co.jp/>

※3 三菱電機グループ環境ビジョン2050

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/corporate/sustainability/environment/vision2050/>

※4 フレームワークの策定およびセカンドパーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者

お問い合わせ先

<報道関係からのお問い合わせ先>

三菱電機株式会社 広報部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

TEL 03-3218-2332 FAX 03-3218-2431

<お客様からのお問い合わせ先>

三菱電機株式会社 財務部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

TEL 03-3218-2263 FAX 03-3218-2185